

JOURNAL OF THE SOCIETY OF GRINDING ENGINEERS

Vol.41 No.4 CONTENTS



会 報	会長就任にあたって 庄司克雄	117
	第2回砥粒加工学会論文賞受賞者紹介	118
	第1回砥粒加工学会奨励賞受賞者紹介	118
	平成8年度次世代砥粒加工技術専門委員会活動報告	119
特 集 先端砥粒加工：研磨	CMP装置の現状と展望 辻村 学	120
	精密研磨に利用する金属酸化物ゾル 吉田明利, 太田勇夫, 加賀隆生, 西村 透	124
	移動体通信用水晶素板の研磨技術 佐藤佐知雄	127
連 載	砥粒と化学(2) 「微粒子分散の原理」 河田研治	131
論 文	超精密ELID研削における非球面形状の制御 守安 精, 大森 整, 中川威雄, 加藤純一, 山口一郎	135
	研削加工の改善を実施するための環境コントロール概念の提案 井原 透	142
	高速CMPによるグローバル平坦化時の研磨機構に関する研究(第1報) 佐藤修三	147
編 集 後 記		154

